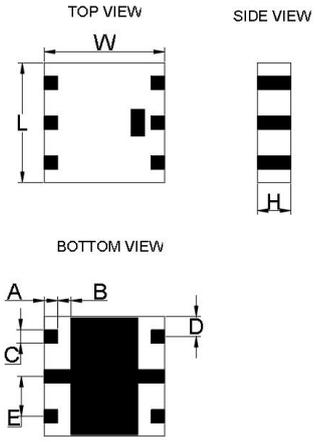


1. 执行标准

GJB9152-2017 低温共烧陶瓷器件通用规范

2. 外型尺寸 (Unit: mm)

器件尺寸

| | | | | | |
|---|------------|---|-------------|---|-----------------|
|  | | | | L | 9.00 ± 0.30 |
| | | | | W | 9.00 ± 0.30 |
| | | | | T | 2.50 ± 0.20 |
| | | | | A | 0.60 ± 0.10 |
| | | | | B | 0.50 ± 0.10 |
| | | | | C | 0.40 ± 0.10 |
| | | | | | |
| 1 | input Port | 2 | output Port | | |
| 3 | GND | 4 | GND | | |

焊盘尺寸

3. 结构及材料

| No. | 名称 | 结构及材料 |
|-----|-------|------------|
| 3.1 | 谐振体 | LTCC 介质材料 |
| 3.2 | 输入/输出 | 银+电镀 Ni/Sn |
| 3.3 | 接地面 | 银+电镀 Ni/Sn |

4.电气性能

| NO. | 项目 | 特性 | |
|---|--------------|-------|-----|
| 1 | 通带频率 (MHz) | 54~68 | |
| 2 | 插损(dB) @25°C | ≤7.5 | |
| 3 | 回波损耗(dB) | ≥10 | |
| 4 | 阻带衰耗(dB) | 40MHz | ≥15 |
| | | 80MHz | ≥30 |
| 5 | 输入/输出差分阻抗(Ω) | 200 | |
| 工作和储存条件 工作温度范围: -40°C ~ +85°C 储存温度范围: -40°C ~ +85°C | | | |
| 焊接前的储存条件 (包含包装材料) 储存温度范围: +5 ~ +40 °C 湿度: 相对湿度 30 to 70% | | | |

5.特性曲线

6.可靠性试验

6.1 温度循环试验

- 温度: -55°C~125°C;
- 温度梯度: (1~5)°C/min (整个温度变化幅度内的平均值);
- 保持时间: 125°C、-55°C各保持 0.5h (每次);
- 循环次数: 10 次;
- 循环结束后对性能指标进行测试, 应满足技术要求。

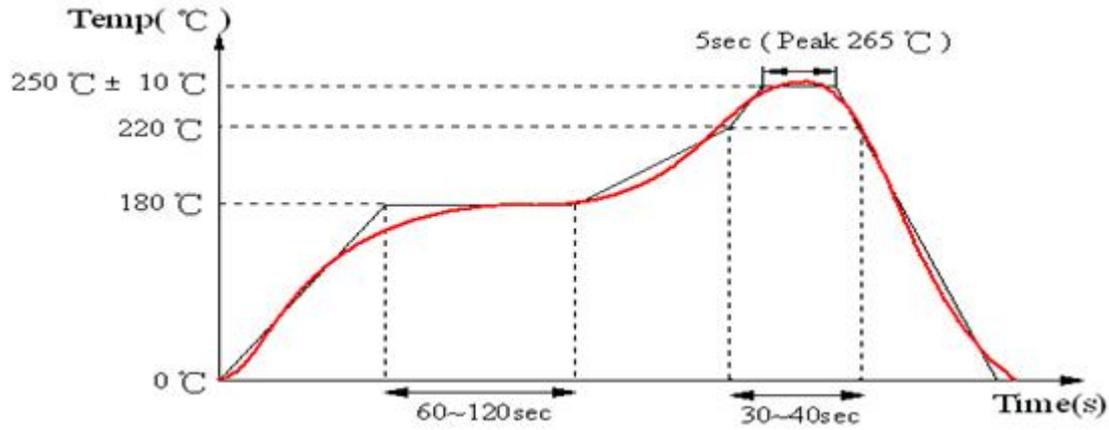
6.2 高温工作试验

- 试验目的: 确定设备在高温条件下工作的环境适应性;
- 试验温度: +85°C, 温度变化速率不超过 10°C/min;
- 持续时间: 设备达到温度稳定后至少保持 20min;
- 要求试验中对产品进行工作性能检测。

6.3 低温工作试验

- 试验目的: 确定设备在低温条件下工作的环境适应性;
- 试验温度: -55°C;
- 持续时间: 设备达到温度稳定后至少保持 20min;
- 要求试验中对产品进行工作性能检测。

7.回流焊温度



8.储存条件

易氧化产品，产品拆封后请于 48 小时内用完或重新密封包装！